

## Contents 目录

1. Description 产品介绍 .....	3
1.1 General Description 产品描述 .....	3
1.2 Features 产品特征 .....	3
1.3 Application 产品应用 .....	3
1.4 Package Dimension 封装尺寸 .....	4
1.5 Product Parameters 产品参数 .....	5
1.6 Bin Range Of Forward Voltage and Luminous Flux 电压与流明分 BIN 范围 .....	7
1.7 Typical optical characteristics curves 典型光学特性曲线 .....	8
2. Packaging 产品包装 .....	12
2.1 Packaging Specification 包装规格 .....	12
2.1.1 Carrier Tape Dimension 载带尺寸 .....	12
2.1.2 Reel Dimension 卷盘尺寸 .....	12
2.1.3 Label Form Specification 标签规格 .....	13
2.2 Moisture Resistant Packing 防潮包装 .....	13
2.3 Cardboard Box 包装纸箱 .....	13
2.4 Reliability Test Items And Conditions 信赖性测试项目及条件 .....	14
2.5 Criteria For Judging Damage 失效判定标准 .....	15
3. SMT Reflow Soldering Instructions SMT 回流焊说明 .....	16
3.1 SMT Reflow Soldering Instructions SMT 回流焊说明 .....	16
4. Handling Precautions 产品使用注意事项 .....	18
4.1 Handling Precautions 产品使用注意事项 .....	18